



2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年11月14日
上場取引所 東

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス
 コード番号 6890 URL <http://www.ferrotec.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山村 章
 問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 丈 TEL 03-3281-8186
 四半期報告書提出予定日 2019年11月14日 配当支払開始予定日 2019年12月6日
 四半期決算補足説明資料作成の有無： 有
 四半期決算説明会開催の有無： 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期第2四半期	41,849	△7.5	3,566	△29.6	2,472	△49.2	1,539	△45.5
2019年3月期第2四半期	45,230	5.2	5,069	12.7	4,866	26.1	2,825	22.9

(注) 包括利益 2020年3月期第2四半期 △630百万円 (-%) 2019年3月期第2四半期 658百万円 (△61.5%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年3月期第2四半期	41.54	41.53
2019年3月期第2四半期	76.37	76.24

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2020年3月期第2四半期	183,978	48,953	26.4	1,310.69
2019年3月期	163,098	49,848	30.3	1,337.33

(参考) 自己資本 2020年3月期第2四半期 48,639百万円 2019年3月期 49,498百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年3月期	—	12.00	—	12.00	24.00
2020年3月期	—	12.00			
2020年3月期（予想）			—	12.00	24.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 2020年3月期の連結業績予想（2019年4月1日～2020年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	85,000	△5.0	6,500	△26.0	4,500	△44.2	2,500	△12.1	67.45

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 ー社 （社名）ー、除外 ー社 （社名）ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 （4）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

（注）詳細は、添付資料10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 （4）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2020年3月期2Q	37,203,702株	2019年3月期	37,106,702株
② 期末自己株式数	2020年3月期2Q	93,568株	2019年3月期	93,568株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2020年3月期2Q	37,066,521株	2019年3月期2Q	37,003,134株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

決算説明会資料は、決算説明会終了後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(会計方針の変更)	10
(セグメント情報等)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における経済状況は、米国経済は景気拡大が緩やかに継続しております。中国経済は、米中の貿易摩擦の影響から景気減速となり不透明感を強めています。我が国では企業活動に回復の兆しが見えたものの、米中貿易摩擦の影響が影を落とし、企業業績に影響がはじめております。また、為替相場は円高方向で推移いたしました。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、半導体メモリや液晶・有機ELパネルなどの設備投資の調整局面が続いており、設備稼働率も低水準で推移しました。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業におきましては、液晶・有機ELパネル製造装置向けの真空シール等が減少し、半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品の販売もユーザーの生産調整の影響を受け計画を下ぶれる結果となりました。

電子デバイス事業におきましては、主力のサーモモジュールは、北米・中国・欧州市場の自動車販売台数の減少により温調シート向けが軟調に推移しました。他の業界用途は、通信システム向けを中心に底堅く推移し、特にパワー半導体用基板が伸長しました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は41,849百万円(前年同期比7.5%減)、営業利益は3,566百万円(前年同期比29.6%減)、経常利益は2,472百万円(前年同期比49.2%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,539百万円(前年同期比45.5%減)となりました。

当第2四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、次のとおりであります。

なお、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を次のとおり変更しております。

当社では、取扱い製品を製品用途の類似性と販売先業種により区分し、従来、「半導体等装置関連事業」「太陽電池関連事業」および「電子デバイス事業」の3区分を報告セグメントとして分類しておりましたが、「太陽電池関連事業」は自社製品販売から撤退し、太陽電池向けシリコン製品のOEM受託製造のみ行っていることから量的な重要性が低下したため、報告セグメントから除外し、「その他」へ異動いたしました。また、従来、「太陽電池関連事業」に属する製品として管理していた「石英坩堝」は製品用途・販売先業種が変化したため「半導体等装置関連事業」に含めて管理する事といたしました。

このため、以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

(半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンウエーハ加工、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

主力の真空シールは、半導体および有機ELパネルなどの製造装置内に装着され、密封空間を保持する機能部品です。半導体や有機ELパネルの設備投資の調整局面が続いた結果、同製品の販売は減収となりました。また、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品など半導体のウエーハプロセスに使用されるマテリアル製品は、各種メモリの価格が下落したため在庫調整により、デバイスメーカー各社の装置稼働率は軟調に推移し、需要は弱いものとなりました。ウエーハ加工は一定の水準で推移しました。尚、8インチウエーハの新工場は、まもなく中国杭州市で竣工する予定です。一方、装置部品洗浄(半導体製造装置、液晶パネル製造装置等の部品洗浄)は、順調に売上が伸長しました。

当該事業は、半導体製造装置の設備投資及び稼働率に連動します。

この結果、当該事業の売上高は27,182百万円(前年同期比1.4%減)、営業利益は2,680百万円(前年同期比47.0%減)となりました。

(電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体などです。

主力の自動車温調シート向けサーモモジュールは、北米市場及び中国市場での自動車販売台数が前年割れとなり弱含みの展開となりました。その他の産業用途では、民生、移動通信システム、医療検査装置など、概ね計画のとおり推移しました。成長著しいパワー半導体用基板は、顧客の在庫調整が発生したものの売上は伸長しました。新たに自動車用途等のAMBパワー半導体用基板の開発に成功し、現在、顧客にてサンプルを評価中です。磁性流体は、スマートフォンのバイブレーション用途がやや軟調に推移しました。

当該事業の各製品は、景気に左右されにくい業種への販売を進めております。

この結果、当該事業の売上高は6,991百万円(前年同期比18.9%増)、営業利益は1,320百万円(前年同期比7.2%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

<資産>

当第2四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ20,879百万円増加し、183,978百万円となりました。これは主に無形固定資産2,765百万円が減少した一方、有形固定資産24,652百万円の増加によるものであります。

<負債>

当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ21,774百万円増加し、135,024百万円となりました。これは主にその他固定負債7,995百万円、社債(1年内償還予定を含む)10,271百万円、長期借入金(1年内返済予定を含む)2,380百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ894百万円減少し、48,953百万円となりました。これは主に利益剰余金1,108百万円が増加した一方、為替換算調整勘定2,070百万円の減少によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,469百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には28,086百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

営業活動の結果得られた資金は933百万円(前年同期比4,470百万円減)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益2,526百万円、減価償却費3,434百万円によるものであります。支出の主な内訳は、仕入債務の減少額2,767百万円、たな卸資産の増加額2,131百万円によるものであります。

<投資活動によるキャッシュ・フロー>

投資活動の結果使用した資金は19,229百万円(前年同期比6,977百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出19,057百万円によるものであります。

<財務活動によるキャッシュ・フロー>

財務活動の結果得られた資金は14,909百万円(前年同期比5,770百万円減)となりました。これは主に社債の発行による収入11,154百万円、長期借入れによる収入6,636百万円、長期借入金の返済による支出4,197百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2019年11月7日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	31,555,540	28,086,533
受取手形及び売掛金	21,460,679	19,699,146
商品及び製品	4,583,886	5,177,727
仕掛品	4,731,734	5,056,167
原材料及び貯蔵品	6,961,265	7,755,673
その他	8,787,154	11,756,939
貸倒引当金	△808,881	△1,250,042
流動資産合計	77,271,378	76,282,144
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	10,788,969	12,531,843
機械装置及び運搬具(純額)	18,255,828	21,675,662
工具、器具及び備品(純額)	7,594,997	7,589,432
土地	1,562,127	1,891,710
リース資産(純額)	404,886	5,558,782
建設仮勘定	37,526,652	51,538,425
有形固定資産合計	76,133,461	100,785,856
無形固定資産		
のれん	165,817	83,410
その他	3,391,260	708,514
無形固定資産合計	3,557,078	791,924
投資その他の資産		
その他	6,449,592	6,420,623
貸倒引当金	△313,108	△302,464
投資その他の資産合計	6,136,484	6,118,159
固定資産合計	85,827,024	107,695,939
資産合計	163,098,402	183,978,084

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	20,887,003	17,986,752
短期借入金	9,603,279	12,182,798
1年内償還予定の社債	1,958,000	3,208,000
1年内返済予定の長期借入金	8,784,598	10,181,663
未払法人税等	678,137	696,592
賞与引当金	1,005,066	983,789
その他	17,264,120	18,683,994
流動負債合計	60,180,206	63,923,591
固定負債		
社債	11,225,000	20,246,000
長期借入金	29,505,377	30,488,873
退職給付に係る負債	596,147	584,047
役員退職慰労引当金	18,300	9,900
訴訟損失引当金	67,320	65,362
資産除去債務	85,291	139,043
その他	11,572,373	19,567,753
固定負債合計	53,069,810	71,100,981
負債合計	113,250,016	135,024,572
純資産の部		
株主資本		
資本金	17,611,151	17,646,568
資本剰余金	18,345,266	18,404,488
利益剰余金	9,923,609	11,032,054
自己株式	△86,644	△86,644
株主資本合計	45,793,383	46,996,466
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	122,212	120,291
為替換算調整勘定	3,707,298	1,636,689
退職給付に係る調整累計額	△124,162	△113,562
その他の包括利益累計額合計	3,705,348	1,643,418
新株予約権	26,172	50,668
非支配株主持分	323,481	262,958
純資産合計	49,848,386	48,953,511
負債純資産合計	163,098,402	183,978,084

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
売上高	45,230,959	41,849,067
売上原価	31,353,771	27,941,107
売上総利益	13,877,187	13,907,960
販売費及び一般管理費	8,808,034	10,341,731
営業利益	5,069,153	3,566,228
営業外収益		
受取利息	29,121	47,525
補助金収入	47,019	358,983
持分法による投資利益	294,368	181,108
為替差益	96,023	—
その他	143,986	198,494
営業外収益合計	610,519	786,111
営業外費用		
支払利息	335,321	540,359
為替差損	—	984,815
その他	478,251	354,739
営業外費用合計	813,573	1,879,914
経常利益	4,866,099	2,472,425
特別利益		
固定資産売却益	—	24,208
投資有価証券売却益	—	42,760
受取保険金	147,740	—
特別利益合計	147,740	66,968
特別損失		
固定資産処分損	166,875	12,450
訴訟損失引当金繰入額	115,685	—
特別損失合計	282,560	12,450
税金等調整前四半期純利益	4,731,279	2,526,944
法人税等	1,921,631	1,080,689
四半期純利益	2,809,648	1,446,254
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△16,308	△93,433
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,825,956	1,539,687

(四半期連結包括利益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
四半期純利益	2,809,648	1,446,254
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△10,767	△1,921
為替換算調整勘定	△2,121,515	△2,066,315
退職給付に係る調整額	10,232	10,600
持分法適用会社に対する持分相当額	△29,311	△19,228
その他の包括利益合計	△2,151,362	△2,076,865
四半期包括利益	658,285	△630,610
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	678,428	△522,243
非支配株主に係る四半期包括利益	△20,142	△108,367

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	4,731,279	2,526,944
減価償却費	2,651,700	3,434,539
のれん償却額	137,605	80,866
株式報酬費用	—	34,743
賞与引当金の増減額(△は減少)	△29,185	379
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	2,700	△8,400
貸倒引当金の増減額(△は減少)	58,314	462,691
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)	115,685	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	3,192	△11,881
受取利息及び受取配当金	△35,760	△51,712
受取保険金	△147,740	—
支払利息	335,321	540,359
為替差損益(△は益)	279,235	404,660
持分法による投資損益(△は益)	△294,368	△181,108
固定資産処分損益(△は益)	166,875	△11,757
投資有価証券売却損益(△は益)	—	△42,760
売上債権の増減額(△は増加)	△1,324,103	936,054
たな卸資産の増減額(△は増加)	△181,597	△2,131,197
仕入債務の増減額(△は減少)	△214,809	△2,767,988
その他	1,623,909	△1,122,841
小計	7,878,254	2,091,590
利息及び配当金の受取額	38,921	135,235
利息の支払額	△333,522	△536,935
法人税等の支払額	△2,231,653	△756,645
保険金の受取額	51,302	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,403,301	933,245
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△11,114,715	△19,057,029
有形固定資産の売却による収入	29,068	17,759
無形固定資産の取得による支出	△915,290	△66,081
投資有価証券の取得による支出	△1,039	△1,002
投資有価証券の売却による収入	—	142,825
関係会社出資金の払込による支出	△20,412	—
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入	93,235	—
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	△89,992	—
貸付けによる支出	△620	△219,940
貸付金の回収による収入	1,007	1,377
その他	△233,017	△47,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,251,776	△19,229,185

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	3,282,531	2,757,453
長期借入れによる収入	14,247,179	6,636,909
長期借入金の返済による支出	△2,890,338	△4,197,165
リース債務の返済による支出	△71,397	△118,727
社債の発行による収入	6,638,175	11,154,219
社債の償還による支出	△294,000	△979,000
株式の発行による収入	—	33,833
非支配株主からの払込みによる収入	212,029	64,920
配当金の支払額	△443,162	△443,098
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△939	—
その他	△313	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,679,763	14,909,344
現金及び現金同等物に係る換算差額	△759,428	△204,883
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	13,071,859	△3,591,478
現金及び現金同等物の期首残高	23,648,597	31,555,540
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	—	122,471
現金及び現金同等物の四半期末残高	36,720,456	28,086,533

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更)

(IFRS第16号「リース」の適用)

国際財務報告基準を適用している在外子会社において、第1四半期連結会計期間の期首から国際財務報告基準第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則としてすべてのリースについて使用権資産及びリース債務を認識するとともに、使用権資産の減価償却費とリース債務に係る支払利息を計上しております。

IFRS第16号の適用については、経過的な取扱いに従って、リース債務は、適用開始日現在の借手の追加借入利率を用いて割り引いた現在価値で測定しており、使用権資産はリース債務と同額を計上する方法を採用しております。

この結果、第1四半期連結会計期間の期首において、有形固定資産の「リース資産(純額)」が5,367,466千円、流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含まれるリース債務の合計が2,420,139千円増加しており、無形固定資産の「その他」が2,932,782千円、投資その他の資産の「その他」が14,544千円減少しております。

なお、この変更による当第2四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自2018年4月1日至2018年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体 等装置関連事 業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	27,580,086	5,879,204	33,459,290	11,771,669	45,230,959	—	45,230,959
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	131,305	—	131,305	—	131,305	△131,305	—
計	27,711,391	5,879,204	33,590,595	11,771,669	45,362,264	△131,305	45,230,959
セグメント利益又 は損失(△)	5,054,233	1,231,609	6,285,842	△1,194,550	5,091,291	△22,138	5,069,153

(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△22,138千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体 等装置関連事 業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	27,182,121	6,991,181	34,173,302	7,675,764	41,849,067	—	41,849,067
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	245,497	—	245,497	—	245,497	△245,497	—
計	27,427,618	6,991,181	34,418,799	7,675,764	42,094,564	△245,497	41,849,067
セグメント利益	2,680,976	1,320,205	4,001,181	190,892	4,192,073	△625,844	3,566,228

(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△625,844千円には、セグメント間取引の消去599,600千円、各報告セグメントに配分していない全社費用26,244千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、従来、報告セグメントとして開示しておりました「太陽電池関連事業」は、量的な重要性が低下したため、報告セグメントから除外し「その他」に含めております。また、従来、「石英坩堝」は「太陽電池関連事業」に属する製品として管理しておりましたが、製品用途・販売先業種が変化したため「半導体等装置関連事業」に含めて管理する事といたしました。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分により作成したものを記載してあります。